



Initial Product/Process Change Notification

Document # : IPCN22578X

Issue Date: 16 January 2019

Title of Change:	Capacity expansion of Assembly and Test operations of Cebu former Fairchild SOT23 package to ON Semiconductor Leshan, China and change the backmetal site from Bucheon, Korea to ON Niigata, Japan.																												
Proposed First Ship date:	3 June 2019																												
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Joan.Abigail.Enriquez@onsemi.com>																												
Samples:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.Samples@onsemi.com>																												
Type of Notification:	<p>This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. IPCNs are typically issued 30 days prior to the issuance of the Final Change Notice (FPCN). An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan.</p> <p>The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact <PCN.Support@onsemi.com></p>																												
Change Part Identification:	Customer may receive the parts from ON Semiconductor Leshan, China from month of May 2019 onwards once FPCN expire. Parts from ON Semiconductor Leshan, China can be identified through product marking which follow ON Semiconductor marking format.																												
Change Category:	<input checked="" type="checkbox"/> Wafer Fab Change <input checked="" type="checkbox"/> Assembly Change <input checked="" type="checkbox"/> Test Change <input type="checkbox"/> Other _____																												
Change Sub-Category(s):	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 33%;"><input checked="" type="checkbox"/> Manufacturing Site Addition</div> <div style="width: 33%;"><input checked="" type="checkbox"/> Material Change</div> <div style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> Datasheet/Product Doc change</div> <div style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> Manufacturing Site Transfer</div> <div style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> Product specific change</div> <div style="width: 33%;"><input checked="" type="checkbox"/> Shipping/Packaging/Marking</div> <div style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> Manufacturing Process Change</div> <div style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> Other: _____</div> </div>																												
Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: ON Leshan, China (Assembly & Test Site) ON Niigata, Japan (BGBM site)	External Foundry/Subcon Sites: None																											
Description and Purpose:																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Before Change Description</th><th>After Change Description</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LeadFrame</td><td>Ag Plated LF</td><td>Cu Plated LF</td></tr> <tr> <td>Mold Compound</td><td>CK5000A EDALE ELER-8-100HFE</td><td>Henkel GR640 HV L1</td></tr> <tr> <td>Assembly Site</td><td>ON Cebu, Philippines</td><td>ON Leshan, China</td></tr> <tr> <td>Testing Site</td><td>ON Cebu, Philippines</td><td>ON Leshan, China</td></tr> <tr> <td>BGBM Site</td><td>ON Bucheon, Korea</td><td>ON Niigata, Japan</td></tr> <tr> <td>Back metal</td><td>Ti Ni Ag Tin Back metal</td><td>Gold Back metal</td></tr> <tr> <td>Case outline</td><td>318BM</td><td>318-08</td></tr> <tr> <td>Product marking change</td><td>Ex-FCS Format</td><td>ON Semiconductor format</td></tr> </tbody> </table>		Before Change Description	After Change Description	LeadFrame	Ag Plated LF	Cu Plated LF	Mold Compound	CK5000A EDALE ELER-8-100HFE	Henkel GR640 HV L1	Assembly Site	ON Cebu, Philippines	ON Leshan, China	Testing Site	ON Cebu, Philippines	ON Leshan, China	BGBM Site	ON Bucheon, Korea	ON Niigata, Japan	Back metal	Ti Ni Ag Tin Back metal	Gold Back metal	Case outline	318BM	318-08	Product marking change	Ex-FCS Format	ON Semiconductor format	
	Before Change Description	After Change Description																											
LeadFrame	Ag Plated LF	Cu Plated LF																											
Mold Compound	CK5000A EDALE ELER-8-100HFE	Henkel GR640 HV L1																											
Assembly Site	ON Cebu, Philippines	ON Leshan, China																											
Testing Site	ON Cebu, Philippines	ON Leshan, China																											
BGBM Site	ON Bucheon, Korea	ON Niigata, Japan																											
Back metal	Ti Ni Ag Tin Back metal	Gold Back metal																											
Case outline	318BM	318-08																											
Product marking change	Ex-FCS Format	ON Semiconductor format																											

**Qualification Plan:**

DEVICE: BSS123-G, BSS138-G, FDV305N, NDS0610-G
RMS: P48559, S48560, F48537, P48561
PACKAGE: SOT23-3L

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated BV	1008 hours
HTGB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated Vgss	1008 hours
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hours
PC	J-STD-020 / JESD-A113	MSL 1 @260°C	
TC + PC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cycles
H3TRB + PC	JESD22-A101	Ta=85°C, 85% RH, 80% max rated BV	1008 hours
uHAST + PC	JESD22-A118	Ta=130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hours
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

Estimated date for qualification completion: 1 February 2019

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
BSS84	NDS0610-G /BSS138-G
BSS84-G	NDS0610-G /BSS138-G
FDV305N	FDV305N
NDS0605	NDS0610-G /BSS138-G

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号: IPCN22578X

発行日: 16 January 2019

変更件名:	Cebu の旧 Fairchild SOT23 パッケージ製品の組立およびテストを ON Semiconductor Leshan (中国) に拡張、およびバックメタルを ON Bucheon (韓国) から ON 新潟に変更	
初回出荷予定日:	3 June 2019	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Joan.Abigail.Enriquez@onsemi.com> にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。	
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。 IPCN は、通常、最終変更通知 (FPCN) の発行の 30 日前に発行されます。 IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。 また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。 この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。 ご不明な点がありましたら、<PCN.Support@onsemi.com> にお問い合わせください。	
変更部品の識別:	お客様はオン・セミコンダクター 楽山 (中国) 品を、FPCN が承認された場合は 2019 年 5 月から受け取ることができます。 オン・セミコンダクター 楽山 (中国) 品は、オン・セミコンダクターの表示フォーマットに従う製品表示により識別できます。	
変更カテゴリ:	<input checked="" type="checkbox"/> ウェハファブの変更 <input checked="" type="checkbox"/> アセンブリの変更 <input checked="" type="checkbox"/> 試験の変更 <input type="checkbox"/> その他 _____	
変更サブカテゴリ:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input checked="" type="checkbox"/> 製造拠点の追加 <input type="checkbox"/> 製造拠点の移転 <input type="checkbox"/> 製造プロセスの変更 </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> 材料の変更 <input type="checkbox"/> 製品仕様の変更 </div> <div> <input type="checkbox"/> データシート/製品資料の変更 <input checked="" type="checkbox"/> 出荷/パッケージング/表記 <input type="checkbox"/> その他: _____ </div> </div>	
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター 拠点: ON Leshan, China (Assembly & Test Site) ON Niigata, Japan (BGBM site)	外部製造工場 / 下請業者 拠点: なし
説明および目的:		
	変更前の表記	変更後の表記
リードフレーム	Ag Plated LF	Cu Plated LF
モールド・コンパウンド	CK5000A EDALE ELER-8-100HFE	Henkel GR640 HV L1
組み立て拠点	ON Cebu, Philippines	ON Leshan, China
テスト拠点	ON Cebu, Philippines	ON Leshan, China
BGBM 拠点	ON Bucheon, Korea	ON Niigata, Japan
バックメタルの種類	Ti Ni Ag Tin Back metal	Gold Back metal
ケース外形	318BM	318-08
製品表示変更	Ex-FCS Format	ON Semiconductor format



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号: IPCN22578X

発行日: 16 January 2019

認定計画:

デバイス名: BSS123-G, BSS138-G, FDV305N, NDS0610-G

RMS: P48559, S48560, F48537, P48561

パッケージ: SOT23-3L

テスト	仕様	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated BV	1008 hours
HTGB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated Vgss	1008 hours
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hours
PC	J-STD-020 / JESD-A113	MSL 1 @260°C	
TC + PC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cycles
H3TRB + PC	JESD22-A101	Ta=85°C, 85% RH, 80% max rated BV	1008 hours
uHAST + PC	JESD22-A118	Ta=130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hours
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

認定完了予定日: 1 February 2019

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
BSS84	NDS0610-G /BSS138-G
BSS84-G	NDS0610-G /BSS138-G
FDV305N	FDV305N
NDS0605	NDS0610-G /BSS138-G